附件2-4

融合集群其他集成电路贷款项目

资金申请报告

（封面）

**项 目 名 称**

**项目承担单位**

**统一社会信用代码**

**项目负责人**

**联 系 电 话**

**项目主持部门**

**申 报 日 期**

**无锡市发展和改革委员会**

**二○二四年三月**

融合集群其他集成电路贷款项目

资金申请报告编制要点

（内容不超过 3000字）

一、项目的背景和必要性

国内外现状和技术发展趋势对产业发展的作用与影响，产业关联度分析，市场分析，与国家、省、市集成电路产业发展规划、政策相关联情况。

二、项目承担单位基本情况

项目承担单位的所有制性质、主营业务、上年度运营情况、银行信用等级，项目负责人基本情况及主要股东的概况等。

三、项目建设内容和方案

项目建设的主要内容、产能规模、产品方案及关键指标和主要技术经济指标。

四、项目投资和贷款情况

总投资规模、投资使用方案、贷款情况和2022年和2023年付息情况。

五、相关附件

项目承担单位营业执照、项目核准或备案文件（时间为2021年及以后）、与银行签订的贷款合同、2022年和2023年结息凭证、其他有关文件和证明材料。